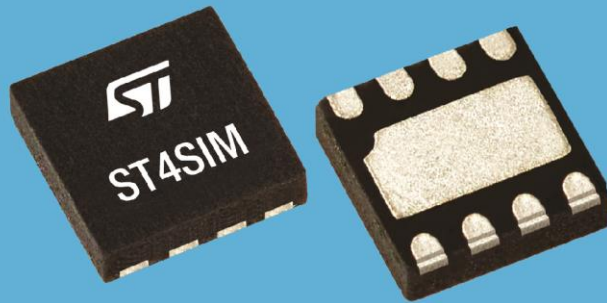




life.augmented



SIM/eSIM for M2M connectivity
now available for mass market



意法半導體針對大眾市場推出ST4SIM 適用M2M之與GSMA相容的eSIM卡晶片

- ❖ 符合GSMA標準的工業和車用SIM/eSIM晶片，現在可透過代理商訂購
- ❖ 配備物聯網裝置連線蜂巢網路所需的全部服務
- ❖ 提供產業標準的外形、尺寸和晶片級封裝

【台北訊，2021年9月27日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）宣布在線上發售針對大眾市場的機器對機器（M2M）嵌入式SIM卡（eSIM）晶片 - [ST4SIM](#)。

意法半導體工業用之eSIM晶片提供物聯網裝置與蜂巢網路連線所需的全部服務，適用於機器運作狀況監測和預測性維護，以及資產追蹤、能源管理和連網的醫療保健等裝置。此外，這些eSIM晶片可讓客戶根據GSMA規範對SIM卡設定檔進行遠端系統管理，無需讀取裝置即可更改網路服務供應商。

意法半導體安全微控制器部行銷總監Laurent Degauque表示，「藉由內建豐富功能和世界一流的初始化服務，ST4SIM系列為眾多M2M應用提供了便利的連網解決方案。現在這款晶片在大眾市場推出，讓各地的開發者將安全靈活的蜂巢網路部署到更多應用中，包括獨立的M2M開發、概念驗證和原型開發專案。」

意法半導體還負責裝置啟動和服務部署，安排客戶使用ST授權合作夥伴 - Truphone所提供的裝置註冊和服務配置平台。透過使用意法半導體ST4SIM探索套件[B-L462E-CELL1](#)，使用者還可以評測在完整生態系統中預整合的全部產品功能。

ST4SIM已通過GSMA認證，並在意法半導體歐洲和東南亞GSMA SAS-UP¹認證工廠製造。其採用產業標準之MFF2 5mm x 6mm DFN8 Wettable Flank封裝。ST4SI2M0020TPIFW現已在意法半導體eStore販售，亦可訂購其它類型封裝，包括高度小型化的晶圓級晶片級封裝（WLCSP）。

關於意法半導體

意法半導體（STMicroelectronics; ST）擁有46,000名半導體技術、產品和方案的創新和創造者，掌握半導體供應鏈和最先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商，意法半導體與逾十萬客戶、上千合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手應對各種挑戰和機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更廣泛。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：www.st.com。

¹ 安全認證計劃通用整合 IC 卡生產